

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-10-001

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
<b>参与单位</b>	安信基金、光大保德信基金、创金合信基金、九泰基金、太平基金、国融基金、方正富邦基金、长盛基金、嘉合基金、深圳惠通基金、海南佳岳私募证券基金、鸿运私募基金、深圳富博领航私募证券投资基金、盛钧私募基金、北京橡果资管、兴证证券资管、顶石资管、敦和资管、中泰证券(上海)资管、江苏新扬船投资、苏州展毅投资、上海泾溪投资、杭州点将台投资、深圳清水源投资、武汉美阳投资、杭州乐信投资、深圳远致瑞信股权投资、德劭投资、深圳丞毅投资、申万宏源研究、中金公司、创富兆业、首盛资本、河清资本、UBS AG、东吴证券、国海证券、长城证券、国元证券、山西证券、上海证券、华创证券、方正证券、华福证券、国盛证券、汇丰前海证券、财通证券、海通证券、兴业证券、德邦证券、国联证券、野村东方国际证券、华金证券、东北证券、中泰证券、民生证券、华泰证券、东方证券、华安证券、中信证券、浙商证券、招商证券、国泰君安、广发证券、高盛（中国）、瑞银证券、中国银河、凯基证券、中银国际证券、个人投资者（排名不分先后）
<b>时间</b>	2024年10月25日 20:00
<b>上市公司接待 人员姓名</b>	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：陈小曼、陈卓璜

投资者关系活  
动主要内容介  
绍

**一、公司2024年前三季度经营情况介绍**

2024年第三季度实现营收14.7亿元、同比增长3%，归母净利润-5,110万元、同比下降130%，扣非归母净利润-4,233万元、同比下降256%。

2024年前三季度实现营收43.5亿元、同比增长9%，归母净利润-3,160万元、同比下降117%，扣非归母净利润-1,357万元、同比下降141%。是公司自2010年上市以来首次亏损。

总资产148亿元、较上年末减少1%；归属于上市公司股东的净资产51亿元、较上年末减少4%。

**二、公司2024年前三季度业绩下滑原因介绍**

2024年前三季度，公司收入表现正常，净利润表现欠佳。主要受FCBGA封装基板业务费用投入较大、子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损拖累、以及计提减值和费用摊销影响。报告期公司归母净利润为-3,160万元，去年同期为19,045万元，主要变化如下：

1、2023年同期出售美国Harbor100%股权，产生投资收益1.45亿元。

2、FCBGA封装基板项目仍处于投入期，成本费用投入较大，对当期净利润形成较大拖累。

FCBGA封装基板项目是公司战略性投资项目，主要配套国内CPU、GPU、FPGA、ASIC等高端芯片的国产化诉求。自2022年以来累计投资规模超33亿元，目前处于市场拓展和小批量生产阶段，但订单规模较小、尚不具备规模效应，导致整体仍处于亏损状态。FCBGA封装基板项目2022年、2023年以及2024年前三季度费用投入（包括人工、折旧、动力和材料费用）分别为10,193万元、39,594万元、53,047万元。

3、子公司宜兴硅谷聚焦高多层PCB，主要面向国内通讯和服务器市场。一方面因国内市场内卷严重导致竞争加剧、价格下降，另一方面因产能未能如期释放，2024年1-9月亏损8,914万元。

子公司广州兴科聚焦CSP封装基板业务，主要面向存储芯片、射频芯片、传感器芯片等领域。因全球经济景气度下降，半导体行业复苏缓慢，导致CSP封装基板行业景气度较低。广州兴科新建产能面临订单不足的现实挑战，2024年1-9月综合产能利用率约50%，导致亏损5,518万元。

2024年1-9月，宜兴硅谷和广州兴科合计亏损14,432万元，同比减少7,722万元。

#### 4、计提减值和费用摊销影响

公司参股公司深圳锐骏半导体股份有限公司主营业务为功率半导体器件的研发、生产和销售。因半导体行业复苏缓慢导致亏损，基于谨慎原则，公司2024年Q3计提减值2,008万元，2024年1-9月累计计提减值2,694万元。

子公司员工激励费用摊销层面，子公司北京兴斐2024年1-9月股权激励费用摊销506万元，子公司广州兴森半导体2024年1-9月股权激励费用摊销1,553万元。

以上计提减值和费用摊销金额合计4,753万元。

### 三、行业整体情况介绍

根据Prismark报告，2024年全球PCB行业呈现结构分化的弱复苏态势，预计全年产值733.46亿美元，同比增长5.5%，从下游来看，2024年上半年仅AI赛道表现突出，服务器、数据中心是表现最好、增速最快的赛道。消费电子如手机和PC行业弱复苏、增长约6.6%；通信行业需求仍较弱，有线基础设施、无线基础设施行业分别下滑3.1%和7.4%，短期仍看不到明显好转的迹象，后续表现主要取决于投资力度能否恢复；工业和医疗行业表现平稳，分别增长3.1%和5.2%。

从PCB行业表现看，AI赛道相关的公司表现最好，与人工智能、高速网络、数据存储关联度高的公司经营表现较好。从产品结构看，HDI板、高多层高速板市场表现最好、增长最快，常规多层板和封装基板市场表现不佳，面临需求不足、竞争加剧、价格下行的挑战。从区域市场看，仍旧表现的是出海逻辑，进入欧美大客户（如AI领域的英伟达、AMD、亚马逊和汽车领域TESLA）供应链体系的公司收入、利润表现好，国内市场仍然比较卷，面临需求不足、竞争加剧和价格下行的挑战。

长期来看，预期2028年全球PCB行业市场规模将达到904.13亿美元，2023-2028年复合增长率为5.4%。高多层高速板（18层及以上）、高阶HDI板和封装基板领域仍有望实现优于行业的增长速度，预期2028年市场规模分别为27.80、153.26、180.65亿美元，2023-2028年复合增长率分别为10.0%、7.8%、7.6%。高速、高密度、高集成是行业未来发展的主要驱动力，也是AI行业发展的主要趋势。

### 四、FCBGA封装基板项目的进展情况介绍

公司FCBGA封装基板项目为公司战略性投资，截至2024年9月底累计投资规模已超33亿元，该项目已完成验厂客户数达到两位数，并已有海外客户完成验厂，样品持续交付认证中，样品应用领域涵盖服务器、AI芯片、智能驾驶、交换机芯片、网卡、通信产品、电视芯片等。产品良率稳步提升，低层板良率突破95%、高层板良率稳定在85%以上，公司已具备20层及以下产品的量产能力，最小线宽线距达9/12um，最大产品尺寸为120\*120mm，20层以上产品、玻璃基板、磁性基板等新产品均处于开发过程中。

公司FCBGA封装基板项目现已进入小批量量产阶段，但目前产能利用率较低，未来放量节奏主要取决于两点，其一是行业整体复苏进展，其二是现有客户量产订单的导入进展。从公司自身而言，在产能、良率方面已做好充分的准备，也已完成从打样到小批量量产的突破。低层板已进入小批量量产阶段，高层板产品封测和可靠性验证在持续推进中，目前已反馈的产品封测结果均为未发现基板异常，并已获得高层板小批量订单，待样品可靠性验证通过后，将开始投料生产，预计时间为2024年第4季度。

从海外同行欣兴电子、景硕科技的经营表现看，三季度整体营收规模和同比增速相较上半年有明显回暖，预期封装基板行业的景气度有望逐步回升。

尽管面临较大的费用负担和利润拖累，公司仍会毫不动摇的坚持FCBGA封装基板业务的战略性投入，一方面持续投入资源提升技术能力、工艺能力和产品良率，通过工厂层面的良好运营表现增强客户信心，为更多打样机会和量产订单的导入打下坚实的基础；另一方面，加大市场拓展力度，在全力拓展国内客户的基础上，持续攻坚海外大客户，争取持续的审厂、打样和量产机会，努力把握海外客户供应链本土化的机会。同时，工厂层面加强成本管控，持续降本减负。

#### **五、公司CSP封装基板业务情况介绍**

2024年1-9月，公司CSP封装基板实现产值8.3亿元，同比增长48%。主要系主要存储客户的份额提升和产品结构优化，韩系存储客户收入占比已超30%。

珠海CSP封装基板项目亏损主要是因为行业整体需求不好，产能利用率未如预期提升，2024年1-9月综合产能利用率约50%。行业大部分公司目

前产能利用率均未达2022年水平，包括台系大厂商。

目前公司CSP封装基板平均单价基本保持稳定，未来也不会以降价作为主要竞争手段。虽然当前行业整体景气度不高，但经过较长时间和较充分的去库存，行业最坏的时候已经过去，未来有望随着整体经济的企稳而逐步回暖。从销售端看，公司CSP封装基板9月份单月订单量已创新高，产能利用率将进一步提升，预计2025年能成为公司的利润增长点。只要公司能保证稳定的交付和质量表现，有望持续提升大客户订单份额。

公司将继续坚守存储赛道，大力拓展射频、多层板等高单价产品，不断优化产品结构，提升高附加值产品比例，提升盈利能力；同时，公司将不断提升自身工艺水平和交付能力，加大市场开拓力度，争取导入更多的客户和产品订单。

#### **六、公司半导体测试板业务情况介绍**

半导体测试板业务与样板业务经营模式类似，属于多品种、多批次、小批量、定制化生产模式，产品单价和附加值较高。

2024年1-9月，公司半导体测试板业务实现产值1.4亿元，产能利用率持续提高，产品良率、准交率和客户满意度持续提升，30层及以上高阶产品的占比持续增长，季度间接单规模、大客户份额占比和产值规模持续增长，营收及盈利能力持续创新高。半导体测试板国内参与企业较少，目前半导体赛道正处于周期底部，从客户反馈来看，需求有所回暖，大部分客户对未来半导体行业的复苏持乐观态度。

#### **七、北京兴斐电子有限公司经营情况介绍**

北京兴斐聚焦于高密度PCB领域，产品类别包括HDI板、类载板、FCCSP基板和采用BT材质的FCBGA基板，产品应用领域包括高端手机主板和副板、光模块等。手机业务约占整体收入80%，主要订单以韩系手机客户和国内主流手机客户的高端机型为主。

2024年1-9月，北京兴斐受益于战略客户高端手机业务的恢复性增长和份额提升，实现收入62,139万元、净利润8,130万元，经营表现稳定，利润表现较好。北京兴斐年中已启动产线升级改造项目，更换处理能力及效率更高的关键设备，旨在增加面向AI服务器领域如加速卡、高端光模块等产品的产能，把握AI时代的行业机会。

光模块目前景气度较高，客户更关注产品质量及交付稳定性，产品单

	<p>价较高，盈利能力较强，北京兴斐已逐步完成国内相关客户的验厂及打样工作，预计2025年逐步上量，未来几年，光模块业务会是北京兴斐重要的增量所在。</p> <p style="text-align: center;"><b>八、公司PCB业务介绍</b></p> <p>2024年1-9月，公司PCB业务实现产值超32亿元、同比增长5%。公司PCB样板业务收入和利润表现均维持稳定，业务基本盘未发生变化，Fineline PCB贸易业务因欧洲市场需求较弱导致收入和净利润略有下滑。</p> <p>宜兴硅谷高多层板业务经营表现不好，近期主要聚焦两方面工作，其一是导入数字化管理系统，提升管理效率；其二是降本增效提质，目前整体经营状况有所好转，良率提升、交付改善、成本逐步下降、订单持续导入，预期四季度能够继续减亏。未来宜兴硅谷除聚焦通信市场外，还会投入较大的资源和力量聚焦服务器、交换机、计算和存储赛道，重点提升产品结构、良率和交付表现，努力实现经营改善和盈亏平衡的目标。</p>
附件清单	无
日期	2024年10月25日